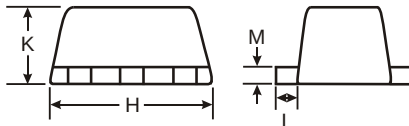
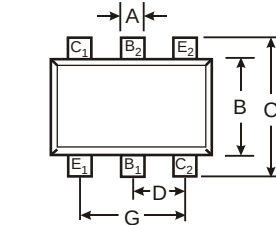


Features

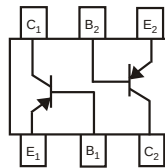
- Σ Epitaxial Planar Die Construction
- Σ Ideal for Low Power Amplification and Switching
- Σ Ultra-Small Surface Mount Package
- Σ **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- Σ **"Green" Device (Note 4)**

Mechanical Data

- Σ Case: SOT-563
- Σ Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Σ Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Σ Terminal Connections: See Diagram
- Σ Terminals: Finish - Matte Tin annealed over Copper leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Σ Marking & Type Code Information: See Last Page
- Σ Ordering Information: See Last Page
- Σ Weight: 0.003 grams (approximate)



SEE NOTE 2



SOT-563			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.25
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D	0.50		
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.56	0.60	0.60
L	0.10	0.30	0.20
M	0.10	0.18	æ
All Dimensions in mm			

Maximum Ratings @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	-40	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	-40	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I _C	-200	mA
Power Dissipation (Note 3)	P _d	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{qJA}	833	°C/W
Operating and Storage and Temperature Range	T _j , T _{STG}	-55 to +150	°C

Thermal Characteristics @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3)	P _d	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{qJA}	833	°C/W

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Package is non-polarized. Parts may be on reel in orientation illustrated, 180° rotated, or mixed (both ways).
 3. Device mounted on FR-4 PCB, 1 inch x 0.85 inch x 0.062 inch; pad layout as shown on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.
 4. Diodes Inc's "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 5)					
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-40	∞	V	$I_C = -10\text{mA}$, $I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-40	∞	V	$I_C = -1.0\text{mA}$, $I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5.0	∞	V	$I_E = -10\text{mA}$, $I_C = 0$
Collector Cutoff Current	I_{CEX}	∞	-50	nA	$V_{CE} = -30\text{V}$, $V_{EB(OFF)} = -3.0\text{V}$
Base Cutoff Current	I_{BL}	∞	-50	nA	$V_{CE} = -30\text{V}$, $V_{EB(OFF)} = -3.0\text{V}$
ON CHARACTERISTICS (Note 5)					
DC Current Gain	h_{FE}	60 80 100 60 30	∞ ∞ 300 ∞ ∞	∞	$I_C = -100\mu\text{A}$, $V_{CE} = -1.0\text{V}$ $I_C = -1.0\text{mA}$, $V_{CE} = -1.0\text{V}$ $I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -1.0\text{V}$ $I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -1.0\text{V}$ $I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = -1.0\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	∞	-0.25 -0.40	V	$I_C = -10\text{mA}$, $I_B = -1.0\text{mA}$ $I_C = -50\text{mA}$, $I_B = -5.0\text{mA}$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$	-0.65 ∞	-0.85 -0.95	V	$I_C = -10\text{mA}$, $I_B = -1.0\text{mA}$ $I_C = -50\text{mA}$, $I_B = -5.0\text{mA}$
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS					
Output Capacitance	C_{obo}	∞	4.5	pF	$V_{CB} = -5.0\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$, $I_E = 0$
Input Capacitance	C_{ibo}	∞	10	pF	$V_{EB} = -0.5\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$, $I_C = 0$
Input Impedance	h_{ie}	2.0	12	kW	$V_{CE} = 10\text{V}$, $I_C = 1.0\text{mA}$, $f = 1.0\text{kHz}$
Voltage Feedback Ratio	h_{re}	0.1	10	$\times 10^{-4}$	
Small Signal Current Gain	h_{fe}	100	400	∞	
Output Admittance	h_{oe}	3.0	60	mS	
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	250	∞	MHz	$V_{CE} = -20\text{V}$, $I_C = -10\text{mA}$, $f = 100\text{MHz}$
Noise Figure	NF	∞	4.0	dB	$V_{CE} = -5.0\text{V}$, $I_C = -100\text{mA}$, $R_S = 1.0\text{kW}$, $f = 1.0\text{kHz}$
SWITCHING CHARACTERISTICS					
Delay Time	t_d	∞	35	ns	$V_{CC} = -3.0\text{V}$, $I_C = -10\text{mA}$, $V_{BE(off)} = 0.5\text{V}$, $I_{B1} = -1.0\text{mA}$
Rise Time	t_r	∞	35	ns	
Storage Time	t_s	∞	225	ns	$V_{CC} = -3.0\text{V}$, $I_C = -10\text{mA}$, $I_{B1} = I_{B2} = -1.0\text{mA}$
Fall Time	t_f	∞	75	ns	

Notes: 5. Short duration test pulse used to minimize self-heating.

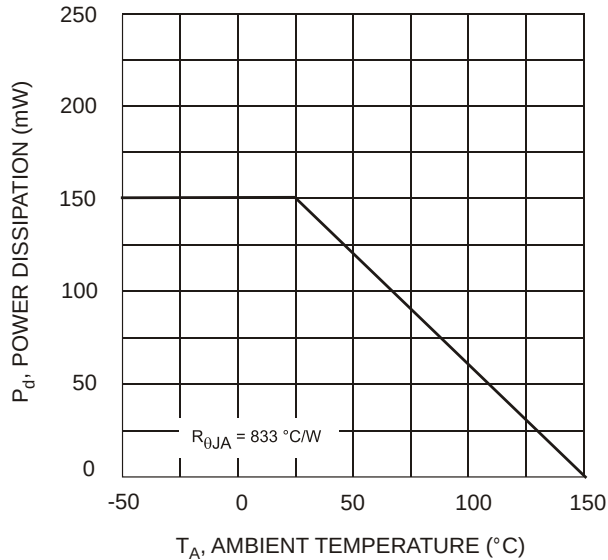


Fig. 1, Derating Curve - Total

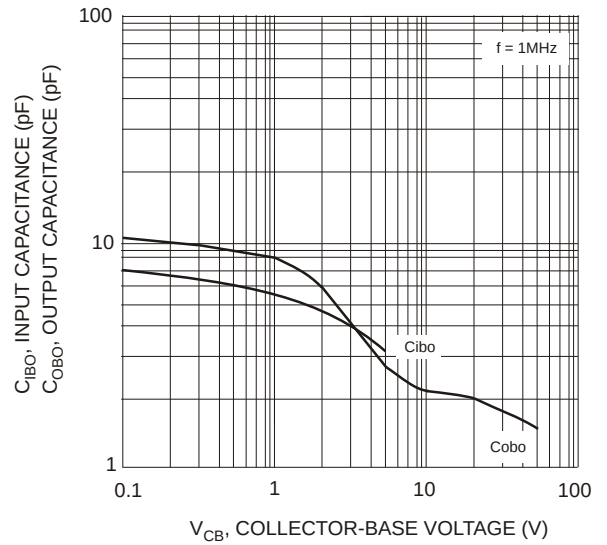


Fig. 2, Input and Output Capacitance vs. Collector-Base Voltage

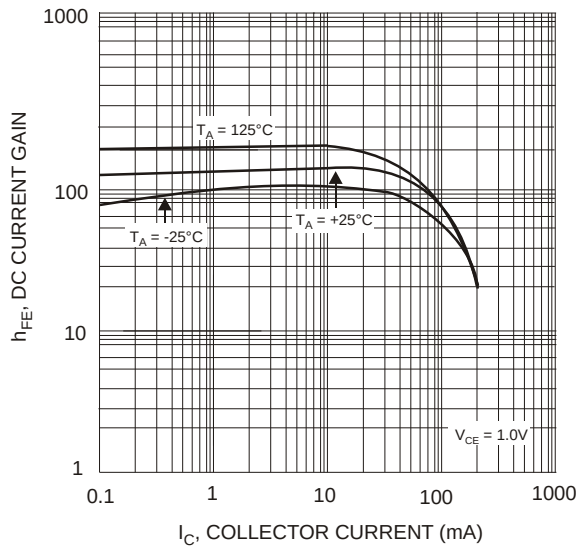


Fig. 3, Typical DC Current Gain vs. Collector Current

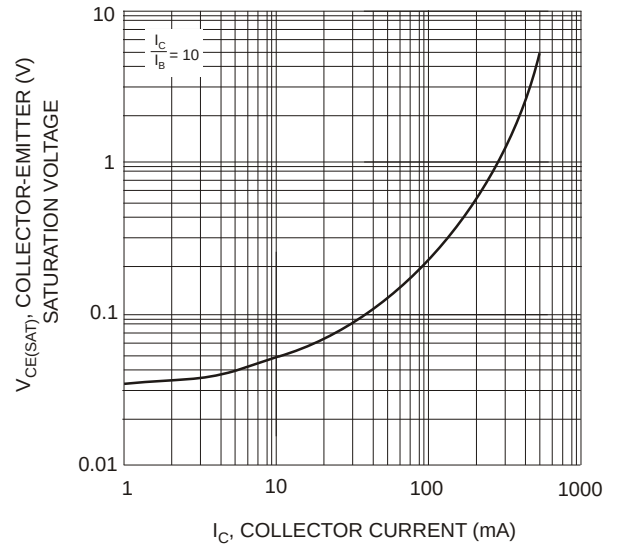


Fig. 4, Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

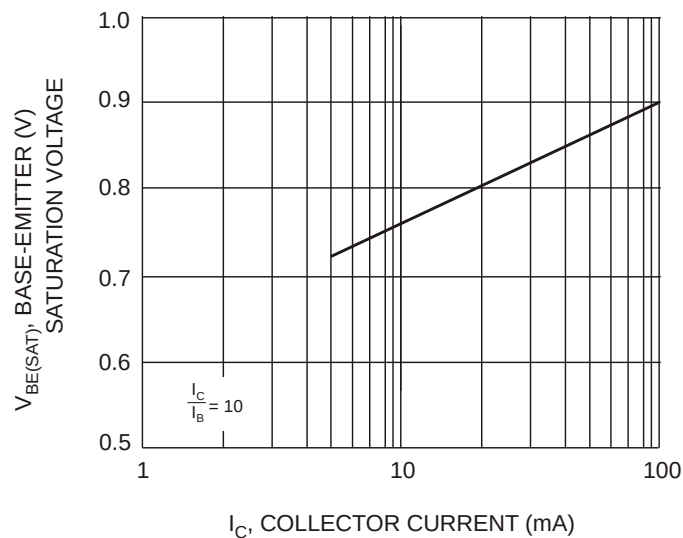
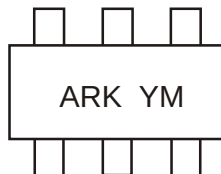


Fig. 5, Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

Ordering Information (Note 6)

Device	Packaging	Shipping
MMDT3906VC-7	SOT-563	3000/Tape & Reel

Notes: 6. For Packaging Details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information


ARK = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: R = 2004
 M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year							2004	2005	2006	2007	2008	2009
Code							R	S	T	U	V	W

Month	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9